

4月市场洞察报告

半导体市场分析与趋势展望

“DISTINCTIVE
INSIGHTS,
INFORMED
DECISION-MAKING”

洞察行情 精准决策

序言

本报告由安芯易电子商务（深圳）有限公司推出，旨在为客户、供应商及合作伙伴提供半导体行业资讯及市场趋势预测，报告涵盖宏观动态、半导体产业动态、终端市场动态、重点产品行情等模块，助力行情洞察、精准决策。

本报告每月更新，可关注安芯易电子微信公众号，及时获取报告发布等信息。您也可以通过联系安芯易客户经理获取完整版报告。

目录

摘要 4

一、宏观动态 6

 (一) 行业政策 6

 (二) 经济指数 7

二、半导体产业动态 12

 厂商动态深度解读 13

三、终端市场动态 18

 (一) 人工智能 20

 (二) 汽车 21

 (三) 医疗 23

 (四) 工业 24

 (五) 机器人 26

四、重点产品行情 28

 (一) 存储芯片 28

 (二) 存储设备 29

 (三) MCU 30

信息来源 32

免责声明 39

摘要

2026 年 4 月重点行情趋势	
宏观动态	● 全球：AI 存储产能全面售罄，HBM 挤占传统 DRAM 加剧短缺至 2030 年 ● 中东：氦气断供叠加能源涨价，半导体材料成本全面攀升 ● 美国：众议院外委会通过 MATCH 法案等多部法案，同步维持三家企业现有产能设备许可 ● 日本：政府批准向 Rapidus 追加 6315 亿日元补贴，累计研发支援达 2.354 万亿日元 ● 中国台湾：产创条例确立“N-1”制程限制，金管会放宽基金持股上限，TSIA 呼吁建立战略储备，官方拒绝美方产能转移要求
产业动态	● 德州仪器：二次涨价 15%-85%，工业/汽车现货价涨 30%-60%，Q1 数据中心业务+90% ● 亚德诺半导体：涨价 5%-10%，期货周期延至 39 周，Q1 通信业务+63% ● 英飞凌：车规 IGBT/SiC 涨 10%-20%，部分高端型号停止接单，AI 服务器功率器件交期 20-50 周 ● 恩智浦：Q1 营收 31.8 亿美元超预期，车规 MCU 最高涨 20%，交期 40 周以上 ● 意法半导体：F1/F4 涨 10%-12%、H7 涨 15%-18%，通用 MCU 交期 12-18 周(车规 36-40 周) ● 瑞萨电子：Q1 营业利润+49.6%，产业事业利润+99.4%，数据中心电源 IC 交期 24-38 周，7 月 1 日涨价 ● 三星电子：Q2 DRAM 再涨 30%，5 月罢工风险或致供应中断，计划 5 月产 HBM4E ● SK 海力士：Q1 利润率 72%创纪录，HBM 产能售罄，12-high 混合键合验证完成 ● 英伟达：4 月 29 日与三星、SK 海力士高管会面，洽谈实体 AI 合作 ● 美光科技：18 亿美元收购铜锣厂，预计贡献 2027 年超 10%全球产能，股价创历史新高 ● 铠侠：日本 7.7 级地震致工厂短暂停工；停产 TSOP MLC NAND，NOR Flash Q2 预期 +40%-50% ● 希捷科技：Q3 营收 31.1 亿美元，2027 年产能基本售罄，年增长目标上调至 20%以上 ● 英特尔：服务器 CPU 涨 10%-20%，交期延至 6 个月，Q3 或再涨 ● 联电：4 月 16 日通知下半年调价，8 吋晶圆涨幅约 10-15%，下半年 8 吋代工成涨价“重灾区” ● 台积电：产能持续缩减，计划 2027 年前全面关闭部分 8 英寸厂
终端市场	人工智能 ● Adobe：Premiere v26.2 和 GPU 加速的 Firefly ● Meta：Llama 4 原生多模态与 MoE 架构 ● NVIDIA：加速 Gemma 4 以实现本地智能体人工智能 ● Anthropic 和亚马逊：1000 亿美元的基础设施和 100 万枚 Trainium 芯片 汽车 ● 特斯拉：AI5 芯片流片及全球产能影响

	● 梅赛德斯-奔驰：2026 款全电动 C 级车首发 ● 丰田：91 亿美元的影响及采购转移 ● 蔚来：将自主研发的芯片规模化推向大众市场 医疗 ● GE 医疗与恩智浦：人工智能在急症护理领域的创新 ● 飞利浦：借助 Verida AI 基础设施，重建速度提升 2 倍 ● 强生医疗科技：利用人工智能实现三维心脏图谱自动化 ● 美敦力：通过 6.85 亿美元投资和收购扩大人工智能规模 工业 ● 施耐德电气：“代理制造”与英伟达的合作关系 ● 霍尼韦尔：2026 年“纯粹”转型 ● 洛克威尔自动化：人工智能编排的系统设计 ● ABB：通过 Genix Copilot 集成扩展 GenAI 机器人 ● Sanctuary AI：液压灵巧性的突破 ● Unitree：人形机器人半程马拉松及硬件可靠性 ● 智元：万台量产与具身智能新阶段 ● 众擎机器人：近 10 亿融资开启全球交付
产品行情	● 存储芯片合约价走高，现货部分型号因提前放量兑现预期，出现价格回调。 ● 企业级存储大涨，AI 存力或成为仅次于 AI 算力的第二大增长引擎 ● 市场全面涨价交期紧，国产车规 MCU 量产加速

一、宏观动态

（一）行业政策

- **全球：AI 存储产能全面售罄，HBM 挤占传统 DRAM 加剧短缺至 2030 年**

4 月，Omdia 将 2026 年全球半导体收入增长预测上调至 62.7%，计算与存储领域同比增速预计达 90%，规模超 7000 亿美元，其中 DRAM 市场接近翻倍，NAND 市场或达 2025 年的四倍，供应明显缓解预计要到 2027 年中后期。高盛预计 2026 年 DRAM 供需缺口达 4.9%，为 15 年来最严重。SK 海力士确认 2026 年 DRAM、NAND 和 HBM 产能全部售罄；美光 2026 年全年 HBM 产能已全部售罄。SK 集团会长指出晶圆供应约束可能持续至 2030 年，供给缺口预计超 20%。三星与 SK 海力士已将 2026 年 HBM3e 供应价格上调近 20%。4 月 27 日，Melius Research 给予美光“买入”评级，目标价 700 美元，给予闪迪“买入”评级，目标价 1350 美元。SK 海力士 Q1 营业利润率达 72%，库存约 4 周。

- **中东：氦气断供叠加能源涨价，半导体材料成本全面攀升**

4 月，中东地缘冲突持续发酵，霍尔木兹海峡封锁进入第二个月，对全球半导体供应链的冲击从单一原材料断供向能源成本、物流运输、化工中间品等领域全面扩散。卡塔尔供应全球约 34% 的氦气，其所有出口须经霍尔木兹海峡。自 2 月 28 日冲突爆发以来，卡塔尔拉斯拉凡工业城氦气设施遭袭，产量大幅下降 14%，修复预计需 3-5 年。氦气现货价格一周内涨幅超过 151%，进口高纯氦气从 75 元/立方米涨至 160 元/立方米以上，涨幅超 113%。氦气在晶圆冷却、刻蚀工艺中尚无替代方案，断供将直接导致晶圆过热及良率大幅下降。三星、SK 海力士已开始密切监控供应，与美国氦气企业签署额外合同锁定库存。与此同时，国际油价在封锁后一周内暴涨超 30%，布伦特原油突破 100 美元/桶。化工原材料环节传导显著：石脑油相关材料价格上涨 20%-30%，日本 Kaneka 宣布聚酰亚胺薄膜和光学级丙烯酸树脂分别上调 20% 和 30%，三菱瓦斯化学将覆铜板价格上调 30%，甲基乙基酮（MEK）现货价格单月飙升 25%。惠誉评级警告，若氦气短缺持续，现货价格涨幅可能达 50%-200%。

- **美国：众议院外委会通过 MATCH 法案等多部法案，同步维持三家企业现有产能设备许可**

4 月 22 日，美国众议院外交事务委员会一揽子通过了包括《硬件技术管制多边协调法案》（MATCH 法案）、《芯片安全法案》在内的 22 项出口管制相关法案。MATCH 法案将管制范围从 EUV 光刻机扩展至所有浸没式 DUV 光刻机及低温蚀刻机等关键设备，并对中芯国际、华为、长江存储、长鑫存储、华虹五家企业实施全面断供，禁止设备出口及维护、软件升级、备件更换等服务。法案为盟友协同执行设置了 150 天倒计时，若荷兰、日本（ASML、东京威力科创）等未能对齐，则将启动外国直接产品规则（FDPR）实施单边域外管制。众议院外交事务委员会民主党首席众议员已对

该法案提出修正案，将实施对象范围缩至中芯国际、长江存储、长鑫存储三家，修正案已获委员会通过，法案后续仍在立法推进中。《芯片安全法案》（3月26日委员会高票通过）则要求出口至中国的先进 AI 芯片须内置位置验证、防篡改、远程锁死及使用追踪等安全机制，商务部须在 180 天内发布实施标准。美国半导体行业协会（SIA）公开反对，称该机制未经测试且可能不可行。与此同时，美国商务部已向三星电子、SK 海力士和台积电分别发放了 2026 年度设备进口许可证，允许三家企业维持其在中国工厂的现有产能，但限制扩产与技术升级。中国商务部回应称将坚决采取必要措施维护中国企业合法权益。

- **日本：政府批准向 Rapidus 追加 6315 亿日元补贴，累计研发支援达 2.354 万亿日元**

2026 年 4 月 11 日，日本经济产业省批准向半导体公司 Rapidus 追加 6315 亿日元（约 39.5 亿美元）补贴，用于支持其 2nm 先进制程 AI 芯片的研发与量产，目标于 2027 财年下半年实现量产。至此，2022 至 2026 年度日本政府对 Rapidus 的累计研发支援总额达 2.354 万亿日元（约 160 亿美元）。Rapidus 计划在 2031 年度左右进行首次公开发行（IPO），并拟通过政府贷款担保寻求约 3 万亿日元的民间融资。同日，经济产业省还宣布对富士通和日本 IBM 的 AI 半导体相关项目提供最高约 900 亿日元补助。日本通过持续大规模财政投入和配套订单支持，试图在 2nm 先进制程领域追赶台积电、三星，但 Rapidus 后续商业化验证仍面临较大不确定性。

- **中国台湾：产创条例确立“N-1”制程限制，金管会放宽基金持股上限，TSIA 呼吁建立战略储备，官方拒绝美方产能转移要求**

2026 年 4 月，《产业创新条例》第 22 条修订案正式引入“N-1”规则，限制台积电最先进制程不得出口至境外工厂，违规可处最高新台币 1000 万元罚款，经济部将于 6 个月内拟定子法。金管会于 4 月 23 日宣布将基金投资单一上市公司持股上限从 10% 提升至 25%，自 4 月 24 日起生效，该规定仅适用于台积电（市值占台股逾 40%），新政生效后台积电股价大涨逾 5%。TSIA 于 4 月 8 日呼吁政府提高氦气、天然气战略储备，并在安全合规前提下支持重启核电以保障稳定供电。针对美国商务部长提出将台湾约 40% 半导体产能转移至美国的提案，台湾副领导人郑丽君予以明确拒绝。4 月 23 日，特朗普宣称若台湾芯片企业未在一年半至两年内赴美设厂将面临高关税。

（二）经济指数

- **3 月全球制造业 PMI 高位回落，中东冲突加剧供应链成本压力**

2026 年 3 月，全球制造业扩张势头有所放缓。摩根大通全球制造业 PMI 录得 51.8，与 2 月持平，但仍连续第八个月运行于荣枯线上方，显示制造业景气度维持扩张但动能趋稳。从主要经济体来看，美国 PMI 升至 52.3，较 2 月回升 0.7 个百分点，产出与就业指标改善；欧元区 PMI 升至 51.6，较 2 月上升 0.8 个百分点，时隔数月重返扩张区间；日本 PMI 降至 51.6，较 2 月回落 1.4 个百分点，

增长动能有所减弱；中国 PMI 降至 50.0，较 2 月下降 2.1 个百分点，恰处荣枯线，外部需求放缓与成本压力上升形成拖累；韩国 PMI 升至 52.6，较 2 月上升 1.5 个百分点，半导体出口强势提供关键支撑；印度 PMI 降至 53.9，较 2 月下降 3.0 个百分点，但仍为全球主要经济体中 fastest 扩张之一。受中东地缘冲突升级影响，全球贸易流动趋于停滞，投入成本涨幅创近三年新高，供应商交付时间延长至近三年半最差水平。整体来看，AI 芯片需求持续旺盛为半导体及相关制造业提供增长动力，但供应链扰动和成本上涨正在侵蚀企业利润空间，区域分化进一步加剧。

全球各地区制造业 PMI

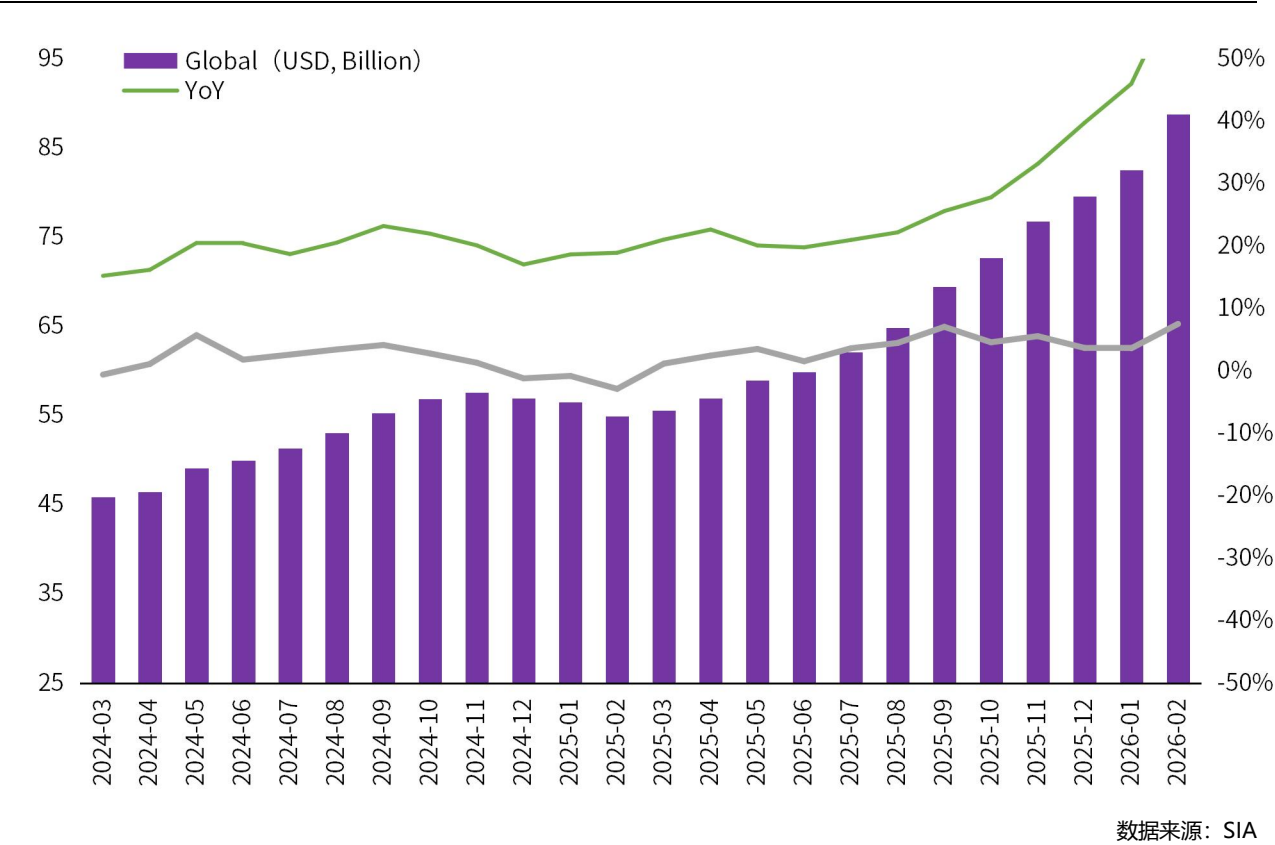
时间	全球	中国	日本	韩国	印度	美国	欧元区
2023-11	49.30	49.40	48.30	50.00	56.00	46.70	44.20
2023-12	49.00	49.00	47.90	49.90	54.90	47.40	44.40
2024-01	50.00	49.20	48.00	51.20	56.50	49.10	46.60
2024-02	50.30	49.10	47.20	50.70	56.90	47.80	46.50
2024-03	50.60	50.80	48.20	49.80	59.10	50.30	46.10
2024-04	50.30	50.40	49.60	49.40	58.80	49.20	45.70
2024-05	50.90	49.50	50.40	51.60	57.50	48.70	47.30
2024-06	49.50	49.50	50.00	52.00	58.30	51.70	45.60
2024-07	49.80	49.40	49.10	51.40	58.10	46.80	45.80
2024-08	48.90	49.10	49.80	51.90	57.50	47.20	45.60
2024-09	48.80	49.80	49.70	48.30	56.50	47.20	45.00
2024-10	48.80	50.10	49.80	48.30	57.50	46.50	46.00
2024-11	50.00	50.30	49.00	50.60	56.50	48.40	45.20
2024-12	49.60	50.10	49.60	49.00	56.40	49.20	45.10
2025-1	50.10	49.10	48.70	50.30	57.70	50.90	46.60
2025-2	50.60	50.20	49.00	49.90	56.30	50.30	47.60
2025-3	50.30	50.50	48.40	49.10	58.10	49.00	48.60
2025-4	49.80	49.00	48.70	47.50	58.20	48.70	49.00
2025-5	49.60	49.50	49.40	47.70	57.60	48.50	49.50
2025-6	50.30	49.70	50.10	48.70	58.40	49.00	50.50
2025-7	49.70	49.30	49.90	48.00	59.20	48.00	49.80
2025-8	50.90	50.50	52.00	48.30	59.30	53.00	50.70
2025-9	50.70	51.20	48.50	50.70	57.70	52.00	49.80
2025-10	50.90	50.60	48.20	49.40	59.20	52.50	50.00
2025-11	50.50	49.90	48.70	49.40	56.60	52.20	49.60
2025-12	50.40	50.10	50.00	50.10	55.00	51.80	48.80
2026-01	50.90	50.30	51.50	51.20	55.40	52.40	49.50
2026-02	51.80	52.10	53.00	51.10	56.90	51.60	50.80
2026-03	51.30	50.00	51.60	52.60	53.90	52.30	51.60

数据来源：Wind

● 2 月全球半导体销售额达 887 亿美元，同比大增 61.8%，AI 需求持续驱动市场增长

2026 年 4 月 3 日，半导体工业协会（SIA）公布数据显示，2026 年 2 月全球半导体销售额达 887 亿美元，较 1 月的 825 亿美元环比增长 7.6%，较 2025 年 2 月的 549 亿美元同比大幅增长 61.8%。SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 表示，全球芯片销售在 2 月维持强劲势头，亚太地区、美洲及中国市场成为同比增速的主要驱动力。从区域来看，同比涨幅方面，亚太/其他地区增长 93.5%，美洲增长 59.2%，中国增长 57.4%，欧洲增长 42.3%，日本下降 0.3%；环比方面，美洲增长 12.6%，欧洲增长 10.2%，亚太/其他地区增长 6.0%，中国增长 3.6%，日本增长 3.0%。SIA 预计，强劲的全球需求将在年内持续，全年全球半导体销售额有望达到约 1 万亿美元。

全球半导体销售额（十亿美元）

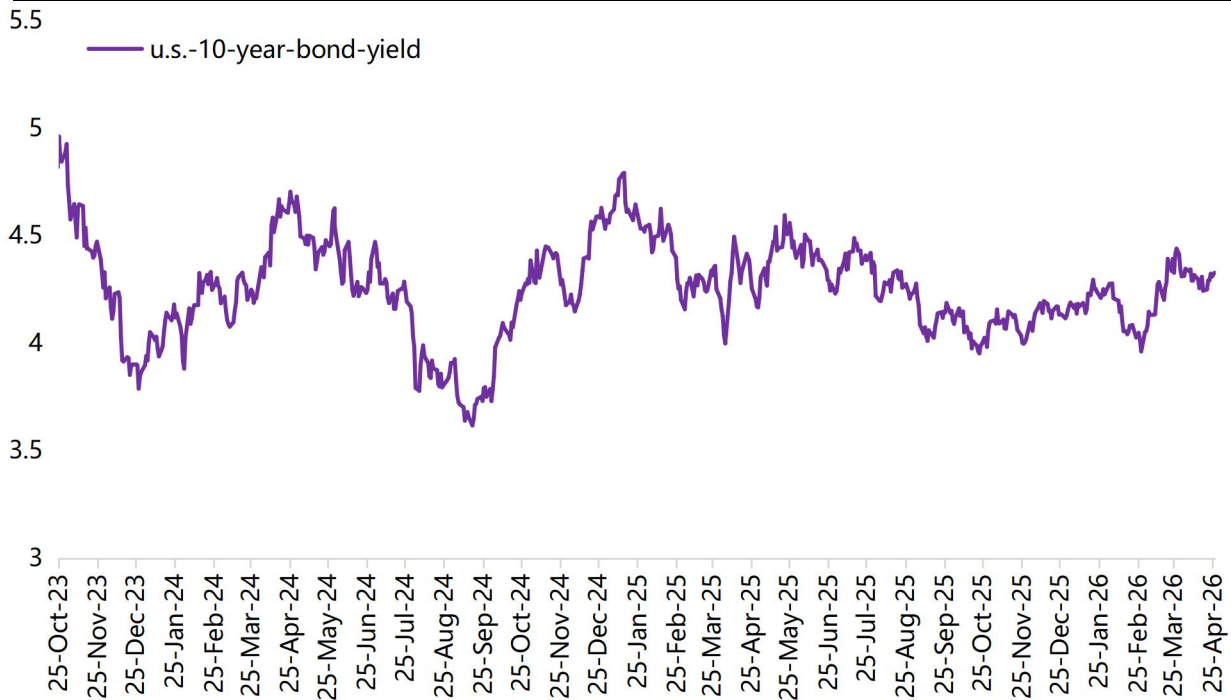


● 4 月美国 10 年期国债收益率震荡下行，地缘风险溢价消退主导回落

2026 年 4 月，美国 10 年期国债收益率整体呈现震荡下行态势，月末收于 4.328%，较 3 月末的 4.44% 累计下行约 11 个基点，月内低点为 4.291%（4 月 8 日），高点为 4.484%（3 月 27 日），波动区间约 4.23%-4.48%。收益率下行的核心驱动力在于地缘风险边际缓和：布伦特原油价格从 3 月末的约 118 美元/桶回落至 4 月中旬的约 102 美元/桶，市场对霍尔木兹海峡封锁的尾部风险溢

价逐步消化。通胀方面，3 月美国核心 CPI 同比仅 2.6%，低于预期，显示剔除能源后通胀压力可控；货币政策层面，美联储 4 月议息会议维持利率在 3.50%-3.75% 不变，市场对年内降息的预期不足一次，利率维持高位的时间预期已充分定价。作为全球资产定价的“锚”，10 年期美债收益率维持在 4.30% 附近，较一季度末高位有所回落，对半导体等高成长性科技板块的估值压力边际缓解，但金融条件整体仍偏紧，后续需关注美伊谈判进展及通胀数据。

美国 10 年期国债利率(%)

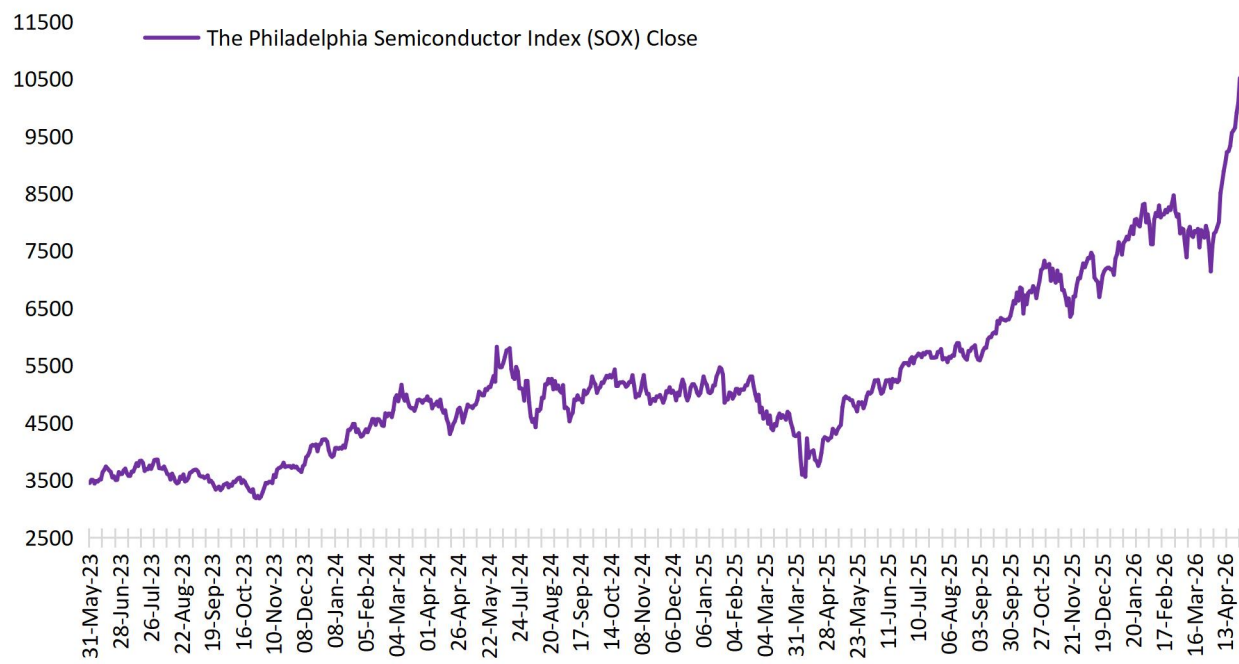


数据来源：Investing

● 4 月费城半导体指数 (SOX) 走势分析：突破万点创历史新高，AI 算力需求与利率预期改善双轮驱动

2026 年 4 月，费城半导体指数 (SOX) 从 3 月末的 7,545.42 点强势拉升，4 月 24 日收于 10,513.70 点，盘中最高触及 10,564.00 点，突破一万点整数关口，月度累计涨幅逾 40%，或创 2000 年 2 月以来最大单月涨幅；指数自 3 月 31 日以来实现连续 18 个交易日上涨，创 32 年历史上最长连涨纪录。本轮上涨核心驱动力来自 AI 算力需求持续超预期（英伟达市值重返 5 万亿美元，H100 租赁价格同比上涨近 40%，全球 CPU 市场进入 5%-20% 的涨价通道）以及 10 年期美债收益率从 3 月末 4.44% 回落至 4.30% 附近，为高估值科技板块提供估值修复空间。短期快速上涨后技术性回调压力显现，但全球半导体行业景气度在 AI 需求与先进制程推进下维持上行态势。

费城半导体指数(SOX)



数据来源: MacroMicro

二、半导体产业动态

半导体产业动态概览			
厂商	动态事件	关键数据	趋势/影响（含具体型号）
德州仪器 TI	4月1日二次涨价执行后工业/汽车现货价飙升；Q1 数据中心+90%，	现货价涨 30%-60%；Q1 营收 48.25 亿美元（+19%）	数字隔离器、栅极驱动器（UCC 系列）、电源管理 IC（TPS/TLV 系列） 交期 16-26 周；通用器件价格趋稳
亚德诺 ADI	涨价 5%-10%；AI 挤占致期货延长	期货延至 39 周；Q1 通信+63%、工业+38%	接口隔离 IC（ADuM 系列）、Maxim PMIC（MAX17xxx） 交期 19-40 周；服务器/汽车型号仍旺
英飞凌 INFINEON	车规 IGBT/SiC 涨 10%-20%（高端 15%-30%）；部分高端停单	AI 功率器件交期 20-50 周	车规 IGBT（FS 系列）、SiC 模块（CoolSiC™）、低压 MOSFET（IPW/IPB/IKW 系列） 产能被 AI 挤占
恩智浦 NXP	Q1 营收 31.8 亿美元超预期；车规 MCU 最高涨 20%	车规 MCU 及 CAN 收发器交期 40 周+；TEF8388 雷达量产	车规 MCU（S32K、MPC57 系列）、CAN 收发器（TJA1042） 交期 40 周以上
意法半导体 STMicroelectronics	4月26日涨价执行；通用与车规分化	F1/F4 涨 10%-12%，H7 涨 15%-18%；通用 MCU 交期 12-18 周，车规 36-40 周	通用 MCU（STM32F1/F4） 交期改善；车规级 MCU（STM32F 系列） 仍紧张；电源管理 IC、EEPROM 缺料
瑞萨电子 Renesas	Q1 营业利润+49.6%；数据中心电源 IC 需求强劲；7月1日涨价	营收 3,723 亿日元（+20.6%）；产业事业利润+99.4%	服务器 CPU 多相控制器（ISL9931、RAA270）、SPS 交期 24-38 周；双路 MOSFET（UPA2756GR-E1-AT） 涨幅 10-15%
三星电子 Samsung	Q2 DRAM 再涨 30%；5月罢工风险；计划5月产 HBM4E	DDR5 比黄金贵 45.9%；罢工或影响 DRAM 产出 3%-4%	HBM4E、DDR5（16Gb）、LPDDR5X 产能向 AI 倾斜；CXL 系统性能提升 10.2 倍
SK 海力士 SK Hynix	Q1 利润率 72%创纪录；HBM 产能售罄；12-high 混合键合验证完成	营收 52.58 万亿韩元（首破 50 万亿）；营业利润+405%	HBM3E/HBM4、321 层 NAND（V9） 领先；混合键合设备已订购

英伟达 NVIDIA	4 月 29 日与三星、SK 海力士会面，洽谈实体 AI 合作	合作尚处早期，未公布具体项目	Orin/Thor 芯片与 HBM、先进封装协同开发实体 AI
美光 Micron	18 亿美元收购铜锣厂；股价创历史新高	预计贡献 2027 年超 10%全球产能；市值近 6000 亿美元	HBM、先进 DRAM 扩产，长协签至 2028 年
铠侠 Kioxia	日本 7.7 级地震致工厂短暂停工；停产 TSOP MLC NAND	已复产；NOR Flash Q2 预期再涨 40%-50%	TSOP 封装 MLC NAND (8Gb-64Gb) 停产；NOR Flash 价格续涨
希捷科技 Seagate Technology	Q3 数据中心+55%；2027 年产能基本售罄；年增长目标上调至 20%+	营收 31.1 亿美元 (+44%)；自由现金流 9.53 亿美元	近线硬盘 (Mozaic 4+ 44TB) 出货；Mozaic 5 (50TB) 2027 年底送样
英特尔 Intel	服务器 CPU 涨 10%-20%；交期延至 6 个月；Q3 或再涨	消费级涨 5%-10%；Q3 再涨或达 8%-10%	至强服务器 CPU (Xeon 6 系列) 交期 6 个月；AI 负载中 CPU:GPU 比例缩至 1:4
联电 UMC	4 月 16 日通知下半年调价，8 吋晶圆涨幅约 10-15%	稼动率超 100%；12 吋成熟涨 5-10%	晶圆代工成熟制程全面转紧，8 英寸晶圆成此轮涨价核心战场
台积电 TSMC	8 英寸产能逐步缩减至 2027 年关停	月产能约 52.8 万片；2nm 预估售价 2.6 万美元/片	3nm、2nm 先进制程涨价；8 英寸产线关停致成熟产能收缩

厂商动态深度解读

- **德州仪器：二次涨价 15%-85%，工业/汽车现货价涨 30%-60%，Q1 数据中心业务+90%**

4 月 1 日，德州仪器第二轮全面涨价正式执行，涨幅 15%-85%，覆盖数字隔离器、栅极驱动器、电源管理 IC 等工控与车规核心芯片。涨价执行后，工业与汽车类核心产品现货报价较 3 月上涨 30%-60%，交期延长至 16-26 周。通用物料在现货市场异常活跃，部分供应商报价有效期缩短至一小时，代理渠道 PPV 报价难获取，部分年前订货型号已延期。4 月 23 日 Q1 财报显示营收 48.25 亿美元 (+19%)，净利润 15.45 亿美元 (+31%)，数据中心收入同比+90%，表明 AI 服务器需求正从 GPU 向模拟芯片全面传导。Q2 营收指引 50-54 亿美元，高于市场预期。

● **亚德诺半导体：涨价 5%-10%，期货周期延至 39 周，Q1 通信业务+63%**

4 月 1 日全系涨价 5%-10%生效，Maxim PMIC 产品线涨幅居前。受 AI 产能挤占，ADI 期货周期由 20 周以内大幅延长至 39 周。具体交期：接口隔离 IC、开关与多路复用器 IC 为 19-22 周，线性产品 24-40 周，Maxim 产品 19-40 周。2026 财年 Q1 通信业务 +63%，工业业务+38%，显示 AI 基础设施投资正强力拉动模拟芯片多元化需求。

● **英飞凌：车规 IGBT/SiC 涨 10%-20%，部分高端型号停止接单，AI 服务器功率器件交期 20-50 周**

4 月 1 日涨价全面生效，功率开关及 IC 涨 5%-15%，车规 IGBT、SiC 模块及高端 MOSFET 涨 10%-20%，高端型号涨幅达 15%-30%。部分高端车规型号已停止接单，AI 服务器功率器件交期 20-50 周，高密度电源管理 IC 超 52 周。受 Nexperia 缺货影响，英飞凌替代品功率 MOSFET (IPW/IPB/IKW 系列) 出现联动涨价。德累斯顿新工厂夏季启用，但上半年供不应求局面难以根本改变。

● **恩智浦：Q1 营收 31.8 亿美元超预期，车规 MCU 最高涨 20%，交期 40 周以上**

恩智浦 4 月 1 日已对 9000 多个型号完成调价，车规 MCU 涨幅最高达 20%。汽车微控制器 (S32K、MPC57 系列) 及 CAN 收发器 (TJA1042、TJA1044) 持续供不应求，交期普遍维持在 40 周以上，部分达 40-50 周。4 月 28 日，公司发布 2026 年第一季度财报：营收 31.8 亿美元，同比增长 12%，超出市场预期；Non- GAAP 每股收益 3.05 美元。汽车、工业、通信基础设施及移动终端四大板块全面增长。管理层表示，TEF8388 第三代雷达收发器已量产，支撑 576 天线成像雷达，赋能 L2+至 L4 级自动驾驶。展望第二季度，恩智浦预计营收 33.5 亿至 35.5 亿美元，显著高于市场预期。

● **意法半导体：F1/F4 涨 10%-12%、H7 涨 15%-18%，通用 MCU 交期 12-18 周 (车规 36-40 周)**

4 月 26 日涨价生效，STM32F1/F4 通用系列涨 10%-12%，STM32H7 高性能系列涨 15%-18%。交期方面，低压/高压 MOSFET、IGBT、ESD 10-26 周，32 位 MCU 15-28 周，通用 F/L 系列缩短至 12-18 周，车规级仍长达 36-40 周。电源管理 IC 和 EEPROM 出现阶段性缺料。交期分化表明 ST 正主动将通用产能腾挪给车规高价产品。

● **瑞萨电子：Q1 营业利润+49.6%，产业事业利润+99.4%，数据中心电源 IC 交期 24-38 周，7 月 1 日涨价**

4 月 24 日 Q1 财报：营收 3,723 亿日元 (+20.6%)，营业利润 1,254 亿日元 (+49.6%)，

产业/基础设施/IoT 事业利润+99.4%，几乎翻番。车用事业营收 1,717 亿日元(+10.6%)，营业利润 618 亿日元(+33.8%)。服务器 CPU 多相控制器及 SPS (ISL9931、RAA270 等) 需求强劲，交期 24-38 周，现货已涨价。部分客户寻求长期供应协议，公司预告 7 月 1 日将涨价。

● **三星电子: Q2 DRAM 再涨 30%，5 月罢工风险或致供应中断，计划 5 月产 HBM4E**
4 月三星宣布 Q2 DRAM 合约价在 Q1 翻倍基础上再涨 30%。据 DRAmEXchange 截至 4 月 7 日数据，服务器 DDR5 16Gb 每克价格约 327,749 韩元，超黄金 45.9%。产能上，90%新增晶圆产能投向 HBM 和服务器 DRAM。同时正式停产 LPDDR4/4X，2027 年 Q1 退出。2nm 良率约 55%。据 News1、朝鲜日报 4 月 23 日报道，工会宣布 5 月 21 日至 6 月 7 日总罢工，KB 证券分析师预计，若罢工成真，DRAM 全球供应将中断 3%-4%、NAND 中断 2%-3%。注意：该预估是针对 5 月全面罢工的研判，而非 4 月 23 日集会结果。此外，三星计划 5 月正式生产首批 HBM4E 工程样品，目标英伟达 Vera Rubin Ultra 加速器平台；CXL 内存系统 “Pangea v2” 性能提升 10.2 倍。

● **SK 海力士: Q1 利润率 72%创纪录，HBM 产能售罄，12-high 混合键合验证完成**

4 月 23 日 Q1 财报显示，营收 52.58 万亿韩元（首破 50 万亿），营业利润 37.61 万亿韩元（同比+405%），营业利润率 72%，净利润率 77%。DRAM 均价环比+60%，NAND+70%。2026 年 HBM 产能已售罄，客户需求远超供给，正转向 3-5 年长期协议。4 月 8 日 321 层 NAND (V9 工艺) 量产。SK 集团会长崔泰源表示，AI 驱动短缺或持续至 2030 年，供应缺口可能超 20%。技术方面，据 The Elec 4 月 29 日报道，SK 海力士已完成 12-high HBM 混合键合验证，正提升量产良率，并已订购应用材料与 Besi 联合开发的混合键合一体化系统（约 200 亿韩元/1500 万美元），为 HBM4 导入混合键合奠定基础。公司计划进一步优化 MR-MUF 技术，已具备基于 HBM3E 最高 16-high 的堆叠能力。三星也引入了 Besi 设备但工具尚不成熟。

● **英伟达: 4 月 29 日与三星、SK 海力士高管会面，洽谈实体 AI 合作**

据韩联社 4 月 29 日报道，英伟达物理 AI 平台产品与技术营销高级总监 Madison Huang 在韩国分别与三星电子、SK 海力士高管举行闭门会谈，聚焦实体人工智能 (Physical AI) 领域合作。会议涉及英伟达 Omniverse 开发平台、机器人平台以及 Orin/Thor 芯片与韩国企业的 HBM、先进封装、传感器制造能力的协同整合，旨在加速具身智能硬件落地。三方计划将英伟达的 AI 算力与韩国的存储和制造优势结合，推动 AI 从云端向物理

世界延伸。目前合作仍处早期磋商阶段，未公布具体项目或时间表。此前一天，Madison Huang 已与 LG 电子、现代汽车高管会面，并在首尔大学发表关于 AI 的演讲。

- **美光科技：18 亿美元收购铜锣厂，预计贡献 2027 年超 10% 全球产能，股价创历史新高**

4 月 16 日完成对力积电铜锣 P5 厂区 18 亿美元收购，该厂拥有约 30 万平方英尺 300mm 无尘室空间，将支持先进 DRAM 及 HBM 生产。TrendForce 分析，铜锣一期预计 2027 年下半年贡献产能，相当于美光 2026 年 Q4 全球产能 10% 以上。4 月股价创历史新高，市值近 6000 亿美元，Melius Research 上调至买入。存储买家正签订 3-5 年长期合同。

- **铠侠：日本 7.7 级地震致工厂短暂停工；停产 TSOP MLC NAND，NOR Flash Q2 预期+40%-50%**

4 月 20 日下午日本岩手县发生 7.7 级强震（日本气象厅测定），铠侠北上工厂（K1、K2）短暂停电停工，厂房未受损，已复产，预计一周恢复。此前 4 月宣布停产 TSOP 封装 MLC NAND，最后出货 2027 年 3 月。NOR Flash 受 AI 驱动，Q2 合约价预期再涨 40%-50%。

- **希捷科技：Q3 营收 31.1 亿美元，2027 年产能基本售罄，年增长目标上调至 20% 以上**

4 月 28 日，希捷发布 2026 财年 Q3 财报（截至 2026 年 4 月 3 日），营收 31.1 亿美元，同比增长 44%，超出分析师预期的 29.6 亿美元；Non-GAAP 每股收益 4.10 美元，同比增长 115%；自由现金流 9.53 亿美元，创十余年新高。数据中心业务营收 25 亿美元（+55%），占总营收 80%。CEO Dave Mosley 宣布进入“结构性增长新时代”，将年收入增长目标从此前的低至中双位数上调至至少 20%。近线硬盘（nearline）产能已与几乎所有主要云厂商完成供应协议，产能基本锁定至 2027 财年全年，正就 2027 财年签订按需定制订单锁定价格。Mozaic 4（第二代 HAMR）已出货，单盘最高 44TB；Mozaic 5 目标 50TB，预计 2027 年底送样。公司预计 Q4 营收 34.5 亿美元，Non-GAAP 每股收益 5.00 美元，远超分析师预期。财报发布后，希捷盘后股价飙升逾 18%。

- **英特尔：服务器 CPU 涨 10%-20%，交期延至 6 个月，Q3 或再涨**

据 4 月下旬多家媒体报道，CPU 市场正迎来一轮由 AI Agent 驱动的全面涨价周期。英特尔已于 3 月上调 PC CPU 价格，并于 4 月 1 日进一步调整服务器 CPU 售价，服务器 CPU 自 3 月以来涨幅达 10%-20%，消费级 CPU 涨幅 5%-10%。市场预期下半年仍有

约 8%-10% 的再涨价空间，将演变为连续第三次提价。交期方面，英特尔服务器 CPU 交期延长至 6 个月（此前仅 1-2 周），AMD 交期约 8-12 周。先进制程产能高度集中是涨价核心推手——英特尔、AMD 主流 CPU 及英伟达 Vera CPU 均竞逐台积电 3nm 产线。英特尔近期以 142 亿美元回购爱尔兰 Fab 34 晶圆厂 49% 股权，强化先进制程控制力。CEO 陈立武在 Q1 财报电话会上表示，AI 负载中 CPU:GPU 比例已从 1:8 缩小至 1:4（训练 7-8:1，推理 3-4:1），CPU 正重新成为 AI 技术栈的调度层。TrendForce 预计 CPU 供给紧张将贯穿至 2027 年。

- **联电：4 月 16 日通知下半年调价，8 吋晶圆涨幅约 10-15%，下半年 8 吋代工成涨价“重灾区”**

4 月 16 日，联电向客户正式发出调价通知，预告 2026 年下半年调整晶圆价格。联电强调调价主因并非单一成本转嫁，而是建立在“整体需求维持韧性、产能环境趋紧及公司将持续投入技术、提升效率与产能扩充等多重因素之上”。供应链消息指联电 8 吋晶圆是本波调价最显著区块，涨幅约 10-15%，主要因台北与厦门厂稼动率维持高檔甚至逾 100%，供需明显偏紧；12 吋晶圆以 80nm、55nm、40nm 等成熟节点为主，涨幅约 5-10%，低于 8 吋水准。此前晶合集成（Nexchip）已宣布自 6 月 1 日起对新产出晶圆统一涨价 10%，世界先进自 4 月起调涨，力积电也证实已陆续涨价，成熟制程晶圆代工正在拉开一轮集体涨价潮。业界分析认为，8 吋产能由供需两端同步收紧（台积电和三星双双淘汰老旧 8 吋产线，而 AI 电源管理芯片需求持续上扬）是此次 8 吋代工成为涨价重点的根本原因，而联电在 4 月发出通知正是成熟制程价格走强的最明确信号。新价格将自 7 月 1 日起产出的晶圆开始适用，以晶圆生产周期约三个半月推算，客户 4 月起投片的部分订单实际已开始对应下半年新报价。

- **台积电：产能持续缩减，计划 2027 年前全面关闭部分 8 英寸厂**

台积电在 4 月 16 日法说会上明确表示 6 吋和 8 吋产线正在逐步汰除，并计划在 2027 年前全面关停部分 8 英寸晶圆厂。目前台积电在中国台湾拥有四座 8 英寸晶圆厂，月产能约 52.8 万片。TrendForce 预计 2026 年全球 8 英寸晶圆产能预计将进一步减少 2.4%。台积电建议客户将 12 英寸成熟制程（22/28/40nm）推进到先进制程，或逐步转移给世界先进等比价合作伙伴。

三、终端市场动态

终端市场动态概览		
类别	动态	洞察
人工智能	奥多比 Premiere 的调色功能现已完全由 NVIDIA GPU 加速，专为专业内容创作者打造。	PC 升级需求： 拉动高端显卡、PCIe 5.0 SSD 及 1000W+ 电源需求；这些已成为高性能 AI 工作站物料组合的必然选型标准。
	Meta 正式开始 Llama 4 训练，目标是“系统 2”推理和高级多模态智能。	存储压力预警：超长上下文将导致 DDR5 (RDIMM) 和 HBM4 供应极度紧缩，使长单协议 (LTA) 成为确保高密度内存产能储备的战略必要性手段。
	英伟达为本地智能 AI 加速 Gemma 4，将推理从云端转移到边缘设备。	边缘 AI 爆发：算力下沉至本地，带动 AI PC 核心 CPU/NPU 及 DDR5 5600+ 高频内存的周转速度。
	从亚马逊获得了 5GW 的计算能力，为 Claude 模型部署了超过 100 万个 Trainium2 芯片。	配套组件机会：自研 ASIC 绕过通用 GPU。商机转向配套的高性能 PMIC、液冷散热组件和高速接口芯片。
汽车	特斯拉成功完成 AI5 芯片流片，该芯片旨在为数百万台 Robotaxis 和 Optimus 机器人提供动力。	产能抢夺预警：AI5 投产将占用大量先进制程产能，相关需求正向高阶 PMIC、4D 毫米波雷达芯片及高功率密度电感等配套器件转移
	梅赛德斯-奔驰发布了 2026 款纯电动 C 级轿车，承诺 WLTP 续航里程可达 762 公里，并配备 39.1 英寸 AI 驱动的 MBUX 超级屏幕。	显示与接口物料激增：39 寸大屏应用正直接拉动 DDIC 和 SerDes 接口芯片需求，同时带动 Tier-1 显示供应链对高速信号缓冲器的需求提升。
	丰田面临 91 亿美元的关税冲击，迫使其将人工智能计算模块的生产大规模转移到北美。	产地策略切换：受产线迁移影响，东南亚出现短期供应缺口，对北美产地认证(NCO)的车载存储和功率 IC 的需求上升，以填补配额不足。
	蔚来创始人李斌确认，将在售价 20 万至 30 万元人民币的车型中全面部署自主研发的智能驾驶芯片。	中端机型物料升级：随着智能驾驶向大众市场渗透，LPDDR5 内存和高密度 NAND Flash 在中端机型中的需求持续增长，带动更大规模的出货机会。
医疗	GE 医疗与恩智浦 (NXP) 合作 (4 月 14 日)，加速人工智能在急症护理领域的创新，这需要高性能的处理能力	高可靠性硬件标准：急症医疗对 MCU/MPU 的“零故障”要求，使得具有车规级可靠性的 NXP i.MX 系列及高精度隔离芯片成为重症监护设备的核心准入门槛。
	飞利浦 Verida 获得 FDA 510(k) 许可，Verida 是一款人工智能驱动的光谱 CT，重建流程速度提高了 2 倍。	高速计算与存储需求：实时影像重构拉动了对车载/工业级 NVMe SSD 和高带宽 GPU 加速器的本地化需求。
	强生公司推出 CARTOSOUND SONATA，利用人工智能实现 3D 心脏映射和成像的自动化。	图像处理元器件标准：实时 3D 建模对高性能 ISP 和 DRAM 缓存提出了极高要求；高带宽内存与低延迟信号处理芯片已成为维持无抖动手术渲染的必备硬件基石。

	美敦力牵头投资 1 亿美元收购 CathWorks，以整合人工智能驱动的冠状动脉评估技术。	基础设施扩容：数字化诊断平台拉动了对 Enterprise SSD 和 FPGA/ASIC 逻辑芯片 的长期采购需求。
工业	霍尼韦尔转型成为一家“纯粹的” 自动化公司，专注于人工智能、5G 和云边缘融合。	高价值重心转移： 向高性能逻辑芯片和工业级存储的转型正在重新定义楼宇自动化的 BOM 结构，确立了高价值芯片作为采购核心优先级的地位。
	施耐德电气推出由 Azure AI 提供支持的“智能制造”，可将工程时间缩短 50%。	基础设施规格升级：AI 工厂架构正推动 HBM、企业级 NVMe SSD 和高效率电源模组需求激增，算力部署重点逐步向工业边缘侧延伸
	罗克韦尔公司在汉诺威工业博览会上推出人工智能协调的工厂设计，利用自主人工智能代理和数字孪生技术。	仿真性能驱： 加速的设计迭代对边缘 AI 处理器和高速数据缓冲器提出更高要求，同时 PLC 升级正在带动核心物料周转加快。
	ABB 通过 Genix Copilot 增强了其数字化解决方案，Genix Copilot 是一款用于工业设备维护和效率的 GenAI 工具。	连接与存储需求爆发： 大规模数据同步正持续拉动工业级 Flash 存储和高性能通信模块的需求。
机器人	Sanctuary AI (4 月 1 日) 在其第八代 Phoenix 液压机械手上演示了零次射击的手内操作。	精密模拟芯片需求：精细操作依赖高保真触觉反馈，从而推动对精密模拟器件的需求。高采样率 ADC 和 DRAM 密集型推理模组将成为应对感官数据处理压力的关键。
	宇树 H1 在北京完成了人形机器人半程马拉松，证明了工业级自主硬件的可靠性。	运动控制组件突破： 长距离移动验证了大功率伺服电机驱动器和高精度磁编码器的耐用性，也为面向量产机型的相关物料储备带来机会。
	智元发布新一代机器人（Expedition A3、Lingxi X3、G2 Max），并达到 10,000 台的生产里程碑。	车规级供应链转向：智元正全面转向车规级 BOM，这将带动对高密度工业级/车规级 NAND 及多轴运动控制芯片的大规模需求。
	融资近 10 亿元人民币，用于构建全球配送网络并升级其 K1 人形机器人产品线。	高成长性产能保障：大规模融资正在加速产能扩张，确立了高性能逻辑芯片与 PMIC 作为支撑全球爆发式订单交付的核心采购保供优先级。

（一）人工智能

● Adobe: Premiere v26.2 和 GPU 加速的 Firefly

Premiere Pro v26.2 推出了重新设计的颜色模式以及由 Firefly 驱动的生成式 AI 视频工具。此次更新包含五种全新的 GPU 加速转场效果（包括通道模糊和渐变）以及用于抠像的 AI 快速选择画笔。通过集成 NVIDIA CUDA-X 库，Adobe 优化了这些智能体工作流，通过 NVIDIA Omniverse 提供实时云流转和高保真 3D 数字孪生，显著降低了企业级内容生产的渲染延迟。这一技术演进加速了工作站从云端渲染向本地 GPU 密集型计算的转型，直接拉动了 RTX 50 系列显卡、1000W+ 高规格电源 (PSU) 以及 PCIe 5.0 SSD 的捆绑需求，使这些组件成为新一代 AI 工作站的核心选型标准。

● Meta: Llama 4 原生多模态与 MoE 架构

Meta 发布了 Llama 4 系列，包括 Scout (109B 总参数/17B 激活) 和 Maverick (400B 总参数/17B 激活) 模型。该版本标志着向混合专家 (MoE) 架构及原生多模态的结构转型，利用“早期融合”技术将文本和视觉 Token 集成到统一的骨干网络中。值得注意的是，Scout 模型支持高达 1000 万 (10M) Token 的上下文窗口；在 Int4 量化下，两款模型均可在单颗 NVIDIA H100 GPU 上运行。10M 超长上下文对 DRAM 存储带宽和容量提出了极限要求，将加剧 DDR5 (RDIMM) 和 HBM4 的供应紧缺，随着 2026 年下半年“存储荒”预警的临近，签署长单协议 (LTA) 已成为高需求企业确保高密度内存模块供应稳定性的核心战略手段。

● NVIDIA: 加速 Gemma 4 以实现本地智能体人工智能

英伟达 (NVIDIA) 宣布通过 NVIDIA RTX AI 工具包对 Google 的 Gemma 4 开放模型进行全面优化。通过利用 TensorRT-LLM 和 INT4 量化技术，英伟达已将复杂的 AI 推理从云端转移到本地 RTX 驱动的 PC 和工作站上，在智能体 (Agentic) 工作

流中实现了 3 倍的性能提升。目前, NVIDIA AI Workbench 已原生支持 Gemma 4, 使开发人员能够构建完全在边缘运行的低延迟、隐私保护型 “智能 AI”, 显著减少了对中心化数据中心基础设施的依赖。算力本地化趋势加速了 AI PC 的换机潮, 确立了 NPU 集成 CPU 和 DDR5 5600+ 高频内存模组作为企业级智能体工作站的新性能基准。

- **Anthropic 和亚马逊: 1000 亿美元的基础设施和 100 万枚 Trainium 芯片**
亚马逊 (Amazon) 宣布对 Anthropic 追加 50 亿美元投资 (总计达 130 亿美元), 并计划在未来 10 年内投入高达 1000 亿美元的计算支出。Anthropic 目前在 “Project Rainier” (全球最大的计算集群之一) 中使用超过 100 万颗 Trainium2 芯片。新协议锁定了 2026 年上半年高达 5GW 的计算能力, 并随着 Trainium3 芯片的推出, 在年底前扩产至 6GW。这一大规模部署凸显了行业转向自研 ASIC 以缓解英伟达供应限制的趋势。大规模转向自研 ASIC 标志着云服务商正逐步摆脱对通用 GPU 供应线的依赖, 商机正在从通用芯片向定制化 ASIC 周边的高效率电源管理 (PMIC)、先进液冷散热组件以及高速互连芯片转移。

(二) 汽车

- **特斯拉: AI5 芯片流片及全球产能影响**
特斯拉确认其 AI5 芯片已成功流片。AI5 专为高推理自动驾驶和机器人设计, 预计其性能将是当前 Hardware 4 (HW4) 的 10 倍。马斯克预计, 为支持全球 Robotaxi 车队和 Optimus 生产, 特斯拉对自研芯片的长期需求可能达到每年 2000 亿颗。这一规模将消耗全球 3nm/5nm 晶圆产能的很大一部分, 可能导致其他汽车 SoC 买家的供应收紧。这种专有硅片的大规模扩展, 可能会挤占先进制程节点的产能, 迫使一级汽车供应商加快转向开发与特斯拉自研架构相配套的专用电源管理芯片 (PMIC) 和高速

数据互连技术。

● 梅赛德斯-奔驰：2026 款全电动 C 级车首发

梅赛德斯-奔驰为其首款全电动 C 级车举行了全球首秀。旗舰款 C400 4MATIC 搭载 94kWh 电池，提供 762km 的 WLTP 续航里程，百公里加速仅需 4.0 秒。该车基于 800V 架构打造，支持 330kW 直流快充，仅需 10 分钟即可增加 325km 续航。内饰核心是搭载全新 MB.OS 系统的 39.1 英寸 MBUX 超级屏，集成了先进 AI，用于处理复杂的乘客交互和导航。向超宽 8K 就绪驾驶舱的转变正在推动对显示驱动 IC (DDIC) 和高带宽 SerDes 接口芯片的需求激增，因此需要与显示模块制造商签订长期供应协议，以缓解高端电动汽车领域高分辨率面板组件的短缺。

● 丰田：91 亿美元的影响及采购转移

由于美国对关键原材料和零部件征收新关税，丰田 (Toyota) 预计将遭受 91 亿美元的负面冲击。为了缓解这些成本，丰田正积极重组其供应链，以实现在美 54.4% 的本地化生产率。对于电子采购而言，这意味着一级供应商模块组装的大规模迁移。这一转型在亚洲造成了暂时的“采购真空”，同时激增了对北美认证的汽车级存储和电源 IC 的需求。这种区域性调整凸显了非中国产 (NCO) 组件采购和本地化物流优化的核心地位，这些已成为在装配线快速向北美转移过程中保障生产连续性的关键措施。

● 蔚来：将自主研发的芯片规模化推向大众市场

蔚来汽车 (NIO) 创始人李斌宣布，公司将在售价 20 万至 30 万人民币 的车型中全面应用其旗舰级智能驾驶芯片和自研操作系统。通过从第三方方案转向自研芯片，蔚来旨在显著降低单车成本，同时针对其特定 AI 模型训练进行优化。此举标志着一个重大转变：随着复杂的自动驾驶栈成为非豪华车型的标配，中端电动车正成为高性能逻辑芯片和高密度 NAND 的大规模消费者。ADAS 硬件的这种普及化将推动对汽车级 LPDDR5 内存和高密度 NAND 闪存的大批量需求，因为大众市场车型开始采用传统

上只用于豪华级别的高性能计算规格。

(三) 医疗

● GE 医疗与恩智浦：人工智能在急症护理领域的创新

GE 医疗 (GE HealthCare) 宣布与 恩智浦 (NXP) 达成战略合作, 旨在加速针对急症护理 (急诊/重症监护) 环境的 AI 创新。该合作伙伴关系专注于将 NXP 的高性能处理能力嵌入到 GE 的医疗设备中, 以实现实时、AI 驱动的患者监测。对于芯片市场而言, 这标志着医疗级 MCU 和 MPU 开始追求汽车级可靠性, 因为急症护理的严苛性质要求在患者床边实现“零停机”逻辑和高速数据吞吐量。这一趋势为医疗硬件设定了新的基准, 高可靠性应用处理器和隔离电源模块已成为核心配置; 特别是符合严格生命安全标准的医疗认证 i.MX 系列和精密模拟组件, 已成为下一代急症护理系统的强制性选型规格。

● 飞利浦：借助 Verida AI 基础设施，重建速度提升 2 倍

飞利浦 (Philips) 的 Verida 光谱 CT 系统获得 FDA 认证。一个关键的技术细节是其全新的 基于 AI 的深度学习重建引擎, 该引擎使系统能够每秒重建 145 幅图像——在不到 30 秒内完成全部检查, 速度比前几代快 2 倍。这种吞吐量的大幅提升得到了 CT 机架内更新的计算基础设施的支持, 需要本地化的高速 NVMe SSD 和高带宽 GPU 加速器来处理实时光谱数据流。从分发的角度来看, 吞吐量的激增需要转向工业级 NVMe 存储和成像机架内的先进冷却解决方案, 以管理 AI 驱动的光谱处理产生的热量和数据密度。

● 强生医疗科技：利用人工智能实现三维心脏图谱自动化

强生医疗科技 (J&J MedTech) 推出了 CARTOSOUND SONATA 模块。这款由 AI 驱动的工具可自动将心内超声 (ICE) 图像转化为高保真的心脏腔室 3D 地图。对于硬件

市场而言，这些地图的自动化生成需要专门的图像信号处理器（ISP）和先进的 DRAM 缓冲区，以便以极小的抖动处理和渲染实时解剖数据。这代表了强生向“智能”电生理学的转变，实时 AI 建模现在已成为核心硬件需求为高带宽 DRAM 和低延迟信号处理芯片创造了大量机会。这一技术飞跃确立了高带宽 DRAM 与低延迟信号处理芯片作为下一代手术系统 BOM 中不可或缺的硬件基石。

- **美敦力：通过 6.85 亿美元投资和收购扩大人工智能规模**

美敦力（Medtronic）已为其心血管 AI 产品组合投入超过 6.85 亿美元，其中包括以 5.85 亿美元收购 CathWorks。这一战略投资旨在全球范围内部署 AI 驱动的 FFR（血流储备分数）测量。为了支持这一点，美敦力正在构建专门的 AI 诊断基础设施，这需要强大的企业级 SSD 和高性能 FPGA/ASIC 芯片，用于低功耗、高速的冠状动脉图像处理，确保美敦力在 2026 年继续作为高级逻辑芯片的顶级消费者。此次整合确立了企业级闪存存储和专用 AI 加速器作为维持全球规模数字化诊断基础设施的战略采购基准。

（四）工业

- **霍尼韦尔：2026 年“纯粹”转型**

霍尼韦尔（Honeywell）宣布将其生产力解决方案和服务（PSS）业务出售给 Brady Corporation。此举是其战略转型的一部分，旨在到 2026 年底成为一家“纯粹的”自动化公司。通过剥离传统硬件，霍尼韦尔正将资金重新分配到工业自主、5G 和云边缘融合领域。对于芯片市场而言，这意味着霍尼韦尔正从高销量、低利润的条码扫描器转向用于其自主楼宇和工厂系统的高价值、高性能逻辑芯片以及工业级 DRAM/SSD。这一战略转变标志着高性能逻辑控制器和工业级存储已成为下一代自主基础设施的必备硬件标准。

● 施耐德电气：“代理制造”与英伟达的合作关系

施耐德电气 (Schneider Electric) 展示了由 Microsoft Azure AI 提供支持的智能制造 (Agentic Manufacturing) 平台。该系统利用自主 AI 智能体管理整个制造生命周期，成功将工程时间缩短了 50% (将任务周期从数周缩短至数小时)。此外，施耐德与英伟达 (NVIDIA) 推出了针对 NVIDIA Vera Rubin NVL72 架构的新参考设计。这些 AI 原生参考设计的推出，确立了企业级 NVMe 存储、HBM 及高密度电源模块作为高性能 AI 制造节点的强制性基础设施标准。

● 洛克威尔自动化：人工智能编排的系统设计

罗克韦尔自动化 (Rockwell Automation) 在汉诺威工业博览会上宣布向 AI 编排的工厂设计转型。通过将自主 AI 智能体与闭环数字孪生验证相结合，罗克韦尔使工程师能够在部署任何硬件之前，从验证模型直接过渡到经过全面测试的控制器项目。这种“AI 原生” workflow 显著加速了设计迭代，从而推动了对高性能边缘 AI 处理器和能够运行复杂工厂级模拟的高速数据缓冲区的需求。这种“虚拟优先”的工程模型，确立了高性能边缘 AI SoC 与低延迟数据缓冲区作为加速工业数字孪生环境的关键硬件基准。

● ABB：通过 Genix Copilot 集成扩展 GenAI

ABB 通过集成 Genix Copilot 增强了其旗舰级工业设备数字解决方案。这款与微软合作开发的生成式 AI 解决方案可帮助工业企业将海量数据背景化，以进行规范性维护。随着此类 AI 驱动的维护工具在 ABB 超过 6 万名客户群中推广，对工业级闪存存储和高性能连接模块的需求激增，因为大规模 AI 建模需要与云端进行持续的数据同步。GenAI 在 ABB 现有设备群中的广泛部署，确立了工业级闪存存储与高吞吐量连接模块作为维持大规模云边数据同步的必备硬件基石。

（五）机器人

● Sanctuary AI：液压灵巧性的突破

Sanctuary AI 展示了其第 8 代 Phoenix 液压机器人手的零样本在手操控能力。这使得机器人能够在没有针对特定任务进行预训练的情况下操控物体（如带字母的方块），模拟人类级别的灵巧度。其硬件依赖于高保真触觉反馈和高速模数转换器（ADC）来处理实时压力数据。这种“精细操控”的突破推动了对精密模拟芯片和高 DRAM 消耗的推理模块的新硬件需求，以处理精密机器人动作所需的大量传感器输入。这种向复杂触觉感知的转型，确立了高精度 ADC 芯片与高带宽内存（HBM）作为在机器人边缘端实现零样本学习的关键硬件基准。

● Unitree：人形机器人半程马拉松及硬件可靠性

宇树（Unitree）H1 人形机器人在北京亦庄成功完成了半程马拉松，并参加了自主组的竞赛。这一事件不仅是一次速度测试，更是对高扭矩电机和车载计算节点在硬件耐用性和散热管理方面的严苛考验。成功完成 21 公里的跑步证明了宇树的硬件在高负荷持续运行下的稳定性。这一长距离耐力测试的成功完成，确立了高性能伺服驱动控制芯片与抗震本地存储作为工业及户外场景下人形机器人向量产化的验证硬件标准。

● 智元：万台量产与具身智能新阶段

这一大规模生产的里程碑标志着分销商必须从工程样品转向汽车标准逻辑和存储组件的大批量供应链管理。智元机器人（AgiBot）发布了包括 远征 A3 和 灵犀 X3 在内的新一代机器人，并庆祝了其第 10,000 台人形机器人下线。加速过程令人震惊：仅在 2026 年第一季度就生产了 5,000 台，标志着智元已从“技术研发”迈向“现实部署”。这一量产里程碑确立了车规级逻辑组件与高密度工业级/车规级 NAND，作为具身智能平台迈向万台级规模化部署的强制性硬件标准。

● 众擎机器人：近 10 亿融资开启全球交付

众擎机器人 (Booster Robotics) 宣布完成了由北京高精尖产业基金领投的近 10 亿人民币融资。该公司在 2026 年第一季度的商业表现呈爆发式增长，出货量同比激增 500%，新订单增幅超过 800%。其旗舰型号 K1 已在全球 20 个国家交付超过 1,000 台。对于电子元器件市场而言，这种快速规模化需要稳定的高性能逻辑芯片和电源管理 IC (PMIC) 供应，以支持众擎机器人激进的“竞技+教育”及工业部署战略。此次注资确立了高性能处理器与电源 IC 作为维持国际交付快速增长及大规模工业部署的关键战略库存优先级。

四、重点产品行情

(一) 存储芯片

2026 年 4 月存储芯片重点产品行情一览

产品	价格趋势	交期（周）	供需状态
DDR4	上涨	20-30	紧张
DDR5	上涨	16-24	紧张
HBM	上涨	12-52	紧张
NAND Flash	上涨	12-26	紧张
NOR FLASH	上涨	8-26	紧张
eMMC	上涨	52+	紧张
SRAM	稳定	12-52	紧张

信息来源：东方财富网、新浪新闻财经

- 存储芯片合约价走高，现货部分型号因提前放量兑现预期，出现价格回调。

1) 产品动态

- **DDR4:** TrendForce 预估 2026 年第二季度 Consumer DRAM（以 DDR4 为主）合约价将季增 45%至 50%。现货端则出现显著回调,4 月首周,中国渠道 DDR4 8GB 和 16GB 内存条价格双双暴跌 25%，32GB 也跌了 9%。
- **DDR5:** 二季度原厂 DDR5 价格整体上涨约 30%。据 CFM 最新价格显示，2026 年 4 月,DDR5 RDIMM 32GB/64GB/96GB 价格上涨至 650 美元/1220 美元/1980 美元。
- **HBM:** HBM 市场延续上涨态势，高盛预计 HBM 紧缺将持续到 2027 年，2026 年一季度 HBM3E 合约价同比涨幅已超 200%，二季度有望环比再涨 30%~50%。
- **NAND Flash:** TrendForce 最新预测显示，2026 年第二季度 NAND Flash 合约

价将环比上涨 70%—75%，创本轮周期以来新高；现货价格过去一个月持续下滑，累计跌幅已达 30-40%。上游 NAND 晶圆代工投片价已大幅调涨，产能被预订至 2026 年末。

2) 市场趋势

- **供需缺口持续深化：**全球存储芯片供需失衡矛盾进一步加剧。高盛在 4 月发布的研报中预测，2026 年 DRAM 供需缺口将达到 4.9%，远超此前 3.3%的预判，为过去 15 年来最严重的短缺；NAND 与 HBM 的缺口分别达 4.2%、5.1%
- **厂商产能分配逻辑逆转：**主要存储芯片制造商正在调整产能分配策略。美银美林 4 月周报指出，传统 DRAM 的盈利能力已反超 HBM，存储巨头扩产 HBM 的热情明显降温，部分原本划拨给 HBM 的资本开支预算已被转移至传统 DRAM 乃至 NAND。

(二) 存储设备

2026 年 4 月各厂商存储设备交期情况

厂商	产品	交期（周）	交期趋势
Samsung (三星)	消费级 SSD	16-24	延长
Kioxia (铠侠)	企业级 NAND/SSD	20 ~ 40 及以上	延长
Dell Technologies (戴尔)	PowerEdge + 存 储系统	20-28	延长

信息来源：新浪财经

- **企业级存储大涨，AI 存力或成为仅次于 AI 算力的第二大增长引擎**

1) 产品动态

- **SSD：**头部原厂（三星、金士顿）对全系列 SSD 实施不低于 10%的涨价，部分消费级 PCIe 4.0 产品价格较去年低点已暴涨 3 至 4 倍。

- **HDD:** HDD 延续量价齐飞趋势, 主流型号平均涨幅达 46%, 部分型号涨幅超 60%。摩根士丹利报告指出, 2026 年 HDD 整体短缺缺口约 200EB, 供需平衡被推延至 2029 年。

2) 市场趋势

- **市场割裂, 消费降温与企业狂热:** 消费级 SSD 市场价格出现 15%-20% 的短期回调, 内存条也普遍续跌; 而企业级 SSD 市场则因 AI 数据中心的强劲需求维持着上涨趋势和景气度。
- **AI “存力” 成为算力之外的第二竞争赛道:** AI 服务器中 GPU 约 70% 时间处于等待数据状态, 30TB 企业级 SSD 一年内从 3000 美元飙至 17500 美元, 一年涨幅达 472%, 且华为预测至 2035 年 AI 存储需求将增长 500 倍。

(三) MCU

2026 年 4 月各厂商 MCU 交期情况

厂商	产品	交期 (周)	交期趋势
恩智浦 NXP	8 位 MCU	16-39	交期稳定
	32 位 MCU	16-39	交期稳定
	车规 MCU	18-52	交期稳定
瑞萨 Renesas	8 位 MCU	14-18	交期稳定
	32 位 MCU	14-18	交期稳定
	车规 MCU	24	交期稳定
意法半导体 ST	8 位 MCU	13-33	交期延长
	32 位 MCU	13-23	交期延长
	车规 MCU	40-52	交期稳定
英飞凌 Infineon	8 位 MCU	10-26	交期稳定
	32 位 MCU	10-26	交期稳定
	车规 MCU	32-45	交期稳定
微芯	8 位 MCU	4-12	交期延长

Microchip	32 位 MCU	4-18	交期延长
-----------	----------	------	------

信息来源：富昌电子

● 市场全面涨价交期紧，国产车规 MCU 量产加速

1) 产品动态

- **供需两端共同驱动 MCU 全面涨价：**4 月起，多家主流 MCU 厂商全面涨价。意法半导体 (ST) MCU 涨价 10%-18%，恩智浦 (NXP) 车规级 MCU 涨价 8%-20%，英飞凌 (Infineon) 车规级 MCU 及功率器件涨价 5%-20%。AI 服务器产能虹吸+上游原材料涨价为本轮核心驱动力。
- **交期延长，供应压力或延续至 Q4：**车规级与高端 32 位 MCU 整体交期持续拉长，普遍处于 16 至 24 周区间，部分紧缺型号超 30 周。Microchip 部分老旧型号交期更达 52 周。常规标准化 MCU 产品交期也已延至约 23 周（6 个月），供应紧张预计将持续至 2026 年第三至第四季度。

2) 市场趋势

- **人形机器人引爆 MCU 新增量：**人形机器人正成为 MCU 需求的新增长引擎。机器人 MCU 承担电机控制、传感器数据处理、实时通信等功能，单台机器人需搭载数十颗 MCU。但据行业测算，当前全球晶圆厂总产能仅能满足百亿级机器人需求的 2% 左右，且芯片扩产周期长达 3 年以上，产能缺口短期内难以弥合。
- **国产车规 MCU 进入量产快车道：**东风 DF30 芯片已在多款整车完成验证并通过极寒测试，推进量产上车；芯驰科技全系列车规芯片累计出货突破 1200 万片，客户覆盖中国前十大汽车 OEM 集团七家。行业预测 2026 年国产汽车芯片在中国市场份额将提升至 35%。

信息来源

- [1] Axios. "White House Pulls Back on Sweeping AI Chip Export Controls." Axios, March 14, 2026.
- [2] Analog Devices. "Analog Devices Reports First Quarter Fiscal 2026 Results." Analog Devices Official, February 2026.
- [3] ANI News. "'Will provide integrated boost to design, research and industry' : Delhi CM on Semiconductor Policy." aninews.in, April 19, 2026.
- [4] Astute Group. "US export controls redraw semiconductor supply chains as China accelerates domestic chip output." astutegroup.com, March 10, 2026.
- [5] Beom, Kim. "SK Hynix Rejects Memory Peak Fears, Bets on HBM4 and 321-Layer NAND Leadership." ChosunBiz, April 23, 2026.
- [6] chemicalnews.com.cn (China Chemical News). "欧盟批准 2.11 亿欧元投建石墨烯项目." chemicalnews.com.cn, April 14, 2026.
- [7] China Times (工商时报). "專家傳真 - 馬來西亞聚焦半導體與數位經濟 推出稅務優惠." chinatimes.com, March 3, 2026.
- [8] China Times (工商时报). "「台積電條款」上路 當紅 00981A 尷尬了? 專家揭真正大贏家." chinatimes.com, April 27, 2026.
- [9] cls.cn (财联社). "扬杰科技：公司被列入欧盟制裁名单." cls.cn, April 27, 2026.
- [10] CMoney (理財網). "台積電持股放寬讓 0052 最受惠, 00991A 單日大買台積電!" cmnews.com.tw, April 28, 2026.
- [11] Dahe Cailu (大河财立方). "2026 年前两个月中国集成电路出口额同比增长 72.6%." dahecube.com, April 3, 2026.
- [12] Digitimes. "US approval of TSMC equipment exports to China reflects strategy shift." digitimes.com, January 2, 2026.
- [13] EC Compliance. "United States: tougher export control penalties under ECRA." ec-compliance.com, January 9, 2026.
- [14] EENews Europe. "US Chipmaking Tool Exports to China Get Annual Approval." eenewseurope.com, January 2, 2026.
- [15] FTNN News (FTNN 新聞網). "台積電上車攻略 / 金管會送大禮 達人教戰「先

求有、再加碼」2大進場訊號。” ftnn.com.tw, April 27, 2026.

[16] FTNN News (FTNN 新聞網). “台股破 4 萬 ETF 資金狂湧權值股 台積電買盤停不下來。” ftnn.com.tw, April 27, 2026.

[17] Goldman Sachs. “Goldman Sachs Upgrades 2026 DRAM Price Growth Forecast to 250%-280%.” Goldman Sachs Research Report, April 23, 2026.

[18] Infineon Technologies. “Infineon Adjusts Prices for Power Switches and Related ICs Effective April 1.” Infineon Official (via Jiu Yang Gong She), February 6, 2026.

[19] Intel Corporation. “Intel Announces First Quarter 2026 Financial Results.” Intel Newsroom, April 23, 2026.

[20] Investing.com. “United States 10-Year Bond Yield Historical Data (April 2026).” investing.com, April 2026.

[21] Jie, Chen. “Texas Instruments Beats Estimates, Data Center Revenue Soars 90%.” Financial Associated Press, April 23, 2026.

[22] Keith Self, U.S. House of Representatives. “Congressman Keith Self Introduces Bill to Strengthen Enforcement of U.S. Export Control Laws.” keithself.house.gov, November 12, 2025.

[23] Kioxia Corporation. “Kioxia Provides Update on Kitakami Operations Following April 20 Earthquake.” Kioxia Official Website, April 21, 2026.

[24] Koo, Hee-seok. “SK Hynix ‘ Quarterly Sales Top 50 Tln Won for First Time on AI Demand.” Yonhap News Agency, April 23, 2026.

[25] Kuo, Ming-Chi (TF International Securities). “OpenAI Partners with MediaTek and Qualcomm on Smartphone Processor Development, Luxshare Precision as Exclusive Design Manufacturer.” TF International Securities Industry Survey, April 27, 2026.

[26] Microchip Technology. “Microchip Extends Lead Times for Select MCU Products.” Microchip Market Feedback via Xinhua Finance, April 2026.

[27] Micron Technology. “Micron Completes \$1.8B Acquisition of PSMC Tongluo P5 Fab.” Micron Technology, April 16, 2026.

[28] Murata Manufacturing. “Murata Announces Price Adjustment for Select Inductive Components and EMI Suppression Filters.” Murata Manufacturing, March 2026.

[29] Nation Thailand. "Japan adds 631.5bn yen more to support Rapidus 2nm chip production." nationthailand.com, April 11, 2026.

[30] National Business Daily (每日经济新闻). "拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司发生工商变更, 新增国家大基金三期旗下基金等为股东." nbd.com.cn, April 16, 2026.

[31] news.bom.ai (半导体产业洞察). "3440 亿元 '大基金三期' 首批投资浮出水面: 3D 集成设备与 12 英寸车规功率线成重点." news.bom.ai, January 13, 2026.

[32] Nikkei (日本经济新闻). "富士通 1.4 纳米半导体将委托给 Rapidus 制造." nikkei.com, April 1, 2026.

[33] NXP Semiconductors. "NXP Adjusts Prices on Over 9,000 Product Models Effective April 1." NXP Official Documents (via IC Trade), March 11, 2026.

[34] Omdia. "Omdia Raises 2026 Semiconductor Revenue Growth Forecast to 62.7%." Omdia Research Report, April 2026.

[35] onsemi. "onsemi Adjusts Prices on Select Products Effective April 1." onsemi Official Documents (via ICTrade), March 17, 2026.

[36] People's Daily (商务部网站). "商务部新闻发言人就美众议院外交事务委员会通过 MATCH 等法案答记者问." 河南省商务厅, April 25, 2026.

[37] Renesas Electronics. "Renesas Reports First Quarter 2026 Financial Results." Renesas Electronics Corporation, April 24, 2026.

[38] S&P Global. "Global Manufacturing PMI – March 2026 Report." spglobal.com, April 2026.

[39] Samsung Electronics. "Samsung Discontinues LPDDR4 and LPDDR4X Mobile DRAM Production." The Elec (via TrendForce), April 20, 2026.

[40] Securities Times (证券时报). "开局 '十五五', 春耕硬科技 | 政策落地见效叠加强劲需求牵引 科创板半导体产业韧性足." stcn.com, April 2, 2026.

[41] Semiconductor Industry Association (SIA). "SIA Statement on Chip Security Act." semiconductors.org, March 2, 2026.

[42] Semiconductor Industry Association (SIA). "Global Semiconductor Sales Increase Substantially in February." semiconductors.org, April 3, 2026.

[43] SEMI China (SEMI 中国). "日本加码约 270 亿元助推 Rapidus 2nm 芯片量产." semi.org.cn, April 13, 2026.

[44] SEMI Europe. "SEMI Europe Policy Forum Brussels 2026 to Focus on Chips Act 2.0 in Shaping the Future of Europe 's Semiconductor Industry." semi.org, April 14, 2026.

[45] SEMI Europe. "SEMI Europe Policy Forum 2026 in Brussels to Focus on Chips Act 2.0." iconnect007.com, April 16, 2026.

[46] Shanghai Securities News (上海证券报). "被列入欧盟制裁名单 扬杰科技:启动全面应对机制 力争消除误解." cnstock.com, April 27, 2026.

[47] SK hynix. "SK Hynix Posts Record Sales, Profits Amid AI Demand Surge." The Chosun Daily, April 23, 2026.

[48] STMicroelectronics. "ST Announces Price Adjustment on Multiple Product Lines Effective April 26." STMicroelectronics (via EE World), March 31, 2026.

[49] TAIYO YUDEN. "TAIYO YUDEN Announces Price Adjustment for MLCC and Other Components." TAIYO YUDEN Co., Ltd., April 2026.

[50] Texas Instruments. "Texas Instruments Announces First Quarter 2026 Financial Results." Texas Instruments News Center, April 22, 2026.

[51] The Indian Express. "Eye on making Delhi hub for research, design, govt begins drafting semiconductor policy." indianexpress.com, April 20, 2026.

[52] The Paper. "美众议院通过多项出口管制法案，中方：坚决反对滥用出口管制行为，相关法案将严重破坏国际经贸秩序，中方将采取必要措施维护中企合法权益." The Paper, April 25, 2026.

[53] The Tribune. "Semiconductor policy to make Capital hub for research, investment, says Gupta." tribuneindia.com, April 20, 2026.

[54] TSIA (台湾半导体产业协会). 第 15 届第 2 次会员大会，理事长侯永清发表呼吁，2026 年 4 月 8 日.

[55] Want Rich China Times (中时新闻网). "買太少才是最大風險！台股誰還有肉？專家 2 表評：「這 4 檔」將是下一個台積電." wanrich.chinatimes.com, April 27, 2026.

[56] Wind (万得数据). 全球各地区制造业 PMI 历史数据 (2023 年 11 月至 2026 年 3 月) . Wind Database, 2026.

[57] WolfSpeed, TrendForce. "日本 7.7 级强震冲击东北半导体集群." April 21, 2026.

- [58] Xilinx (AMD). "Xilinx Lead Times Extended to 23 Weeks for 7-Series Products." Market Feedback via Xilinx Distributors, April 2026.
- [59] Xinhua News Agency. "China warns against US export control bills, vows to defend firms' interests." 163.com, April 26, 2026.
- [60] YAGEO Corporation. "YAGEO Adjusts Chip Resistor Prices by 15%-20%." YAGEO Official Documents (via BOM Man), April 2026.
- [61] Yahoo Finance. "Philadelphia Semiconductor Index (SOX) Historical Data (March-April 2026)." finance.yahoo.com, April 2026.
- [62] 优分析 UAnalyze. "日本加码扶植 Rapidus 再拨 6,315 亿日圆 並補助富士通、IBM Japan 開發 AI 晶片." uanalyze.com.tw, April 13, 2026.
- [63] 贸法通 (CTILS). "2026 年去马来西亚设厂, 税收优惠规则变了——新奖励架构 (NIF) 全面解读." ctils.com, April 28, 2026.
- [64] 经济部 (Ministry of Economic Affairs, Taiwan). 《产业创新条例》第 22 条修订案, 2026 年 4 月.
- [65] 163.com (网易新闻). "日本批准 6315 亿日元追加补贴 助力 Rapidus 进军 AI 芯片制造." 163.com, April 11, 2026.
- [66] 163.com (网易新闻). "马来西亚投资重大转型! NIF 新框架落地, 高质量投资迎黄金期." 163.com, April 15, 2026.
- [67] NVIDIA. "RTX AI Garage: Adobe Premiere Pro Gets New AI Color Mode." Apr 12, 2026.
- [68] Meta AI. "Introducing Llama 4: The Next Frontier of Multimodal Intelligence." Apr 18, 2026.
- [69] NVIDIA. "RTX AI Garage: Accelerating Open Models with Google Gemma 4." Apr 8, 2026.
- [70] Anthropic. "Anthropic and Amazon Expand Partnership to Accelerate AI Development." Apr 21, 2026.
- [71] GuruFocus. "Tesla Advances AI Chip Development with AI5 Completion." Apr 22, 2026.
- [72] carsales.com.au. "Electric 2026 Mercedes-Benz C-Class Debuts." Apr 15, 2026.
- [73] Digital Dealer. "US Tariff Tracker: Analyzing the Impact and Automaker Response." Apr 20, 2026.

[74] China.org.cn. "China's NEV Exports Surge in Q1 2026 Amid Global Demand." Apr 14, 2026.

[75] GE Healthcare. "NXP and GE Healthcare Accelerate AI Innovation in Acute Care." Apr 14, 2026.

[76] ITN Online. "Philips Gets FDA Nod for Verida AI-Powered Detector-Based Spectral CT." Apr 16, 2026.

[77] Johnson & Johnson. "Johnson & Johnson Showcases CARTO-Powered Innovation at HRS 2026." Apr 21, 2026.

[78] MDDI Online. "Medtronic Doubles Down on Cardiovascular Care Through \$585M Acquisition." Apr 20, 2026.

[79] IoT Analytics. "Top 10 Smart Manufacturing Technology Vendors 2026." Apr 5, 2026.

[80] Schneider Electric. "Schneider Electric Unveils Next-Generation Agentic Manufacturing at Hannover Messe 2026." Apr 16, 2026.

[81] PR Newswire. "Rockwell Automation to Demonstrate AI-Orchestrated Factory System Design at Hannover Messe 2026." Apr 20, 2026.

[82] Automation.com. "ABB Enhances AI Capabilities of Flagship Industrial Device Digital Solutions." Apr 17, 2026.

[83] Sanctuary AI. "In-Hand Reorientation Policy with Letter Cube: A Breakthrough in Dexterity." Apr 1, 2026.

[84] Xinhua News. "Unitree H1 Humanoid Robot Sets New Record for Autonomous Mobility." Apr 19, 2026.

[85] PR Newswire. "AGIBOT Unveils New Generation of Embodied AI Robots and Models." Apr 17, 2026.

[86] Gasgoo. "Embodied AI Company Booster Robotics Completes Nearly 1 Billion Yuan Financing." Apr 17, 2026.

[87] 财联社，机构预计二季度内存合约价涨超 45% 港股存储芯片股应声大涨，2026.4.8

[88] 智通财经，万联证券：关注 PCB、存储等细分赛道及产业链，2026.4.13

[89] 蓝鲸新闻，存储超级周期重启了吗？Q2 DRAM 最高再涨 63%、NAND 冲 75%，2026.4.17

[90] 华尔街见闻，传统 DRAM 太赚钱了！存储芯片巨头扩产 HBM 热情都低了，

甚至长协价也不愿签了, 2026.4.27

[91] 半导体行业观察, 巨头, 扫货 DRAM, 2026.4.8

[92] 半导体产业纵横, 即刻生效! 三星、金士顿宣布 SSD 涨价, 涨幅至少 10%,
2026.4.25

[93] 中国 IC 交易网, AI 引爆存储热潮: 企业 SSD 价格飙升至汽车水平, 2026.4.28

[94] 东方财富网, 华为预测到 2035 年, AI 存储容量需求将比 2025 年增长 500 倍,
2026.4.28

[95] CSDN 博客, 半导体涨价潮, 2026.4.09

[96] 新浪新闻, 人形机器人年产量目标百亿台, 现有芯片供应链如何应对这一爆炸
性需求?, 2026.4.13

[97] 电子工程世界, 东风车规级 MCU 芯片 DF30 稳步推进量产上车, 2026.4.8

[98] 搜狐汽车, 从行驶智能到通用智能, 芯驰科技全栈芯方案引领产业新变革,
2026.4.27

[99] 华尔街见闻, 存储现货市场观望加剧: DRAM 卖家惜售, DDR4 小幅下跌,
NAND 延续跌势, 2026.4.16

免责声明

安芯易电子商务（深圳）有限公司(下称“安芯易公司”)所发布的月度报告由安芯易公司市场部基于现已公开的资料、信息、研究报告等进行整理编制而成。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映安芯易公司在报告发布当期的判断、观点，仅供学习参考之用，不构成对所述产品的出价、征价、要约或要约邀请，不构成任何合同或承诺的基础，不构成买卖任何投资工具或者达成任何交易的推荐，亦不构成任何投资、采购及其他应用建议和指导，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行交易、投资所造成的一切后果或损失，安芯易公司不承担任何法律责任。因此，读者在阅读本报告时应保持警惕，并进行独立的判断和分析。

安芯易公司对本报告中所引用的资料、研究报告所涉及的或从第三方媒体获得的信息及数据的真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示或默示的保证。所发布的信息、观点以及数据有可能因发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，但安芯易公司不承担更新不准确或过时的信息、观点以及数据的义务，在对相关信息进行变更或更新时亦不会另行通知。

该报告版权归安芯易公司及相关内容提供方所有，未经授权，任何人不得以任何方式转载、修改、翻版、分发、复制、发表。

安芯易电子商务（深圳）有限公司

2026 年 4 月



安芯易隶属于Ample Solutions集团,成立于2008年,在全球拥有8个办公室,专注于为全球电子制造业客户提供元器件全球采购及供应链服务。我们始终秉持“专注、专业、坚韧、谦卑”的核心价值观,为客户提供卓越服务,助力客户成功。

我们拥有100+资深采购专家,并与来自全球的10000+供应商建立合作,致力于以更快的速度,更低的成本,为客户解决元器件供应链问题。

在深圳和香港,我们建立了两个高标准品质控制中心,严格遵循国际品质控制体系。从供应商管理到品质检测,全方位地防范风险,确保客户的元器件供应链安全和稳定。



洞察行情 精准决策

